

2021-2027年中国汽车芯片 行业深度分析与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2021-2027年中国汽车芯片行业深度分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/qiche/Y16189MBPE.html>

报告价格：印刷版：RMB 8000 电子版：RMB 8000 印刷版+电子版：RMB 8200

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国汽车芯片行业深度分析与市场年度调研报告》共十章。首先介绍了汽车芯片行业市场发展环境、汽车芯片整体运行态势等，接着分析了汽车芯片行业市场运行的现状，然后介绍了汽车芯片市场竞争格局。随后，报告对汽车芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了汽车芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对汽车芯片产业有个系统的了解或者想投资汽车芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 汽车芯片行业发展环境分析

1.1 国际环境

1.1.1 全球发展规模

1.1.2 亚太地区发展

1.1.3 欧洲主导市场

1.1.4 美国ADAS发展

1.2 政策环境

1.2.1 智能制造政策

1.2.2 集成电路政策

1.2.3 半导体产业规划

1.2.4 “互联网+”政策

1.3 经济环境

1.3.1 国民经济运行

1.3.2 工业经济增长

1.3.3 固定资产投资

1.3.4 转型升级形势

1.3.5 宏观经济趋势

1.4 汽车工业

1.4.1 行业发展势头

- 1.4.2 市场产销规模
- 1.4.3 外贸市场规模
- 1.4.4 发展前景展望
- 1.5 社会环境
 - 1.5.1 互联网加速发展
 - 1.5.2 智能产品的普及
 - 1.5.3 科技人才队伍壮大

第二章 2015-2019年中国汽车芯片行业发展分析

- 2.1 2015-2019年中国汽车芯片发展总况
 - 2.1.1 行业发展概述
 - 2.1.2 产业发展形势
 - 2.1.3 市场发展规模
- 2.2 2015-2019年中国汽车芯片市场竞争形势
 - 2.2.1 市场竞争格局
 - 2.2.2 巨头争相进入
 - 2.2.3 半导体抢占主战场
- 2.3 2015-2019年汽车芯片技术发展进展
 - 2.3.1 技术研发进展
 - 2.3.2 无线芯片技术
 - 2.3.3 技术发展趋势
- 2.4 中国汽车芯片行业发展困境分析
 - 2.4.1 过度依赖进口
 - 2.4.2 技术研发不足
 - 2.4.3 行业发展瓶颈
- 2.5 中国汽车芯片市场对策建议分析
 - 2.5.1 行业发展建议
 - 2.5.2 产业突围策略
 - 2.5.3 企业发展策略

第三章 2015-2019年中国汽车芯片行业产业链分析

- 3.1 2015-2019年中国半导体材料行业运行状况

- 3.1.1 产业发展特点
- 3.1.2 行业销售规模
- 3.1.3 市场格局分析
- 3.1.4 产业转型升级
- 3.1.5 行业发展建议
- 3.1.6 行业发展趋势
- 3.2 2015-2019年中国芯片设计行业发展分析
 - 3.2.1 产业发展历程
 - 3.2.2 市场发展现状
 - 3.2.3 市场竞争格局
 - 3.2.4 企业专利情况
 - 3.2.5 国内外差距分析
- 3.3 2015-2019年中国晶圆代工产业发展分析
 - 3.3.1 晶圆加工技术
 - 3.3.2 国外发展模式
 - 3.3.3 国内发展模式
 - 3.3.4 企业竞争现状
 - 3.3.5 市场布局分析
 - 3.3.6 产业面临挑战
- 3.4 2015-2019年中国芯片封装测试行业发展分析
 - 3.4.1 封装技术介绍
 - 3.4.2 芯片测试原理
 - 3.4.3 主要测试分类
 - 3.4.4 封装市场现状
 - 3.4.5 封测竞争格局
 - 3.4.6 发展面临问题
 - 3.4.7 技术发展趋势

第四章 2015-2019年中国汽车芯片行业区域发展分析

- 4.1 长春
 - 4.1.1 产业发展成就
 - 4.1.2 台企投资动态

- 4.1.3 产业集群发展
- 4.2 芜湖
 - 4.2.1 产业支撑政策
 - 4.2.2 产业基地概况
 - 4.2.3 企业项目建设
 - 4.2.4 产业发展目标
 - 4.2.5 产业发展规划
- 4.3 上海
 - 4.3.1 行业发展成就分析
 - 4.3.2 行业发展促进战略
 - 4.3.3 产业发展专项方案
 - 4.3.4 行业发展瓶颈分析
- 4.4 深圳
 - 4.4.1 产业发展优势
 - 4.4.2 产业发展成就
 - 4.4.3 产业链的市场
 - 4.4.4 产业发展动态
- 4.5 其他地区
 - 4.5.1 合肥市
 - 4.5.2 十堰市
 - 4.5.3 东莞市

第五章 2015-2019年汽车芯片主要应用市场发展分析

- 5.1 ADAS
 - 5.1.1 ADAS发展地位
 - 5.1.2 市场竞争现状
 - 5.1.3 技术创新核心
 - 5.1.4 芯片技术发展
 - 5.1.5 投资机遇分析
 - 5.1.6 发展趋势分析
 - 5.1.7 未来发展前景
- 5.2 ABS

- 5.2.1 系统工作原理
- 5.2.2 系统优劣分析
- 5.2.3 中国发展进展
- 5.2.4 系统发展趋势
- 5.3 车载导航
 - 5.3.1 市场发展现状
 - 5.3.2 企业竞争格局
 - 5.3.3 产品的智能化
 - 5.3.4 发展问题剖析
 - 5.3.5 未来发展方向
- 5.4 空调系统
 - 5.4.1 市场发展形势
 - 5.4.2 市场规模分析
 - 5.4.3 企业竞争格局
 - 5.4.4 未来发展方向
- 5.5 自动泊车系统
 - 5.5.1 系统运作原理
 - 5.5.2 关键技术发展
 - 5.5.3 技术推进动态
 - 5.5.4 未来市场前景

第六章 2015-2019年汽车电子市场发展分析

- 6.1 国际汽车电子市场概况
 - 6.1.1 主要产品综述
 - 6.1.2 行业发展状况
 - 6.1.3 市场规模发展
- 6.2 中国汽车电子行业发展概述
 - 6.2.1 市场发展特点
 - 6.2.2 产业发展地位
 - 6.2.3 产业发展阶段
 - 6.2.4 发展驱动因素
 - 6.2.5 市场结构分析

- 6.2.6 引领汽车发展方向
- 6.3 2015-2019年中国汽车电子市场发展分析
 - 6.3.1 市场规模现状
 - 6.3.2 出口市场状况
 - 6.3.3 市场结构分析
 - 6.3.4 汽车电子渗透率
- 6.4 2015-2019年汽车电子市场竞争分析
 - 6.4.1 整体竞争态势
 - 6.4.2 市场竞争现状
 - 6.4.3 区域竞争格局
 - 6.4.4 市场竞争格局
 - 6.4.5 重点厂商SWOT解析
 - 6.4.6 本土企业竞争策略
- 6.5 汽车电子市场发展存在的问题
 - 6.5.1 市场面临挑战
 - 6.5.2 产业制约因素
 - 6.5.3 创新能力不足
- 6.6 中国汽车电子市场发展策略及建议
 - 6.6.1 产业链构建策略
 - 6.6.2 产业发展壮大对策
 - 6.6.3 产业专项规划构思
 - 6.6.4 网络营销策略分析

第七章 国外汽车芯片重点企业运营分析

- 7.1 高通
 - 7.1.1 企业发展概况
 - 7.1.2 经营效益分析
 - 7.1.3 汽车芯片市场布局
 - 7.1.4 恩智浦收购
 - 7.1.5 市场发展规划
- 7.2 英特尔
 - 7.2.1 企业发展概况

- 7.2.2 经营效益分析
- 7.2.3 新品研发进展
- 7.2.4 未来发展前景
- 7.3 英飞凌
 - 7.3.1 企业发展概况
 - 7.3.2 经营效益分析
 - 7.3.3 汽车芯片业务
 - 7.3.4 未来发展前景
- 7.4 意法半导体
 - 7.4.1 企业发展概况
 - 7.4.2 经营效益分析
 - 7.4.3 产品研发进展
 - 7.4.4 汽车半导体业务
 - 7.4.5 未来发展前景
- 7.5 瑞萨科技
 - 7.5.1 企业发展概况
 - 7.5.2 经营效益分析
 - 7.5.3 企业并购动态
 - 7.5.4 企业合作动态
 - 7.5.5 未来发展前景
- 7.6 博世
 - 7.6.1 企业发展概况
 - 7.6.2 经营效益分析
 - 7.6.3 重点布局领域
 - 7.6.4 未来发展前景
- 7.7 德州仪器
 - 7.7.1 企业发展概况
 - 7.7.2 经营效益分析
 - 7.7.3 产品研发动态
 - 7.7.4 助力互联网汽车
 - 7.7.5 企业合作动态
- 7.8 索尼

- 7.8.1 企业发展概况
- 7.8.2 经营效益分析
- 7.8.3 销售市场形势
- 7.8.4 车用芯片业务
- 7.8.5 企业并购动态

第八章 中国汽车芯片重点企业运营分析

8.1 比亚迪股份有限公司

- 8.1.1 企业发展概况
- 8.1.2 经营效益分析
- 8.1.3 力推芯片国产化
- 8.1.4 未来发展前景

8.2 中芯国际集成电路制造有限公司

- 8.2.1 企业发展概况
- 8.2.2 经营效益分析
- 8.2.3 车用晶片业务
- 8.2.4 未来发展策略

8.3 大唐电信科技股份有限公司

- 8.3.1 企业发展概况
- 8.3.2 经营效益分析
- 8.3.3 业务经营分析
- 8.3.4 汽车芯片业务
- 8.3.5 财务状况分析
- 8.3.6 未来前景展望

8.4 上海先进半导体制造股份有限公司

- 8.4.1 企业发展概况
- 8.4.2 经营效益分析
- 8.4.3 业务经营分析
- 8.4.4 企业合作动态
- 8.4.5 财务状况分析
- 8.4.6 未来前景展望

8.5 珠海全志科技股份有限公司

- 8.5.1 企业发展概况
- 8.5.2 经营效益分析
- 8.5.3 业务经营分析
- 8.5.4 汽车芯片业务
- 8.5.5 财务状况分析
- 8.5.6 未来前景展望

第九章 中国汽车芯片行业投资机遇分析

- 9.1 投资机遇分析
 - 9.1.1 产业爆发增长
 - 9.1.2 巨头加速布局
 - 9.1.3 智能汽车发展加速
- 9.2 产业并购动态
 - 9.2.1 高通
 - 9.2.2 三星
 - 9.2.3 瑞萨电子
- 9.3 并购加速动因
 - 9.3.1 汽车数字化推进
 - 9.3.2 半导体行业助力
 - 9.3.3 汽车数字商机爆发
 - 9.3.4 车用晶圆技术发展
- 9.4 投资风险分析
 - 9.4.1 宏观经济风险
 - 9.4.2 环保相关风险
 - 9.4.3 产业结构性风险
- 9.5 融资策略分析
 - 9.5.1 项目包装融资
 - 9.5.2 高新技术融资
 - 9.5.3 BOT项目融资
 - 9.5.4 IFC国际融资
 - 9.5.5 专项资金融资

第十章 中国汽车芯片产业未来发展前景展望（）

10.1 中国汽车电子市场前景展望

10.1.1 全球市场机遇

10.1.2 市场需求分析

10.1.3 十三五发展趋势

10.1.4 产品发展方向

10.2 中国汽车芯片产业未来前景预测

10.2.1 未来发展规模

10.2.2 市场规模预测

10.2.3 芯片需求市场

图表目录：

图表 亚太各地区晶片销售金额与全球占比（依应用别区分）

图表 2021-2027年美国ADAS市场规模及预期

图表 2019年美国汽车市场ADAS功能使用现状

图表 2021-2027年美国汽车市场防碰撞预警功能安装趋势

图表 智能制造系统架构

图表 智能制造系统层级

图表 MES制造执行与反馈流程

图表 云平台体系架构

图表 2015-2019年中国汽车销量月度增长走势

图表 2015-2019年中国乘用车销量月度增长走势

图表 2015-2019年中国商用车销量月度增长走势

图表 2015-2019年中国1.6升及以下乘用车销量月度走势

图表 2019年中国乘用车市场各系别市场份额情况

图表 2019年中国主要车企汽车销售市场占有率

图表 2015-2019年中国汽车销量月度增长走势

图表 2015-2019年中国乘用车销量月度增长走势

图表 2015-2019年中国商用车销量月度增长走势

图表 2019年汽车商品月度进口金额及同比增长变化情况

图表 2019年七大类汽车商品进口金额所占比重

图表 2015-2019年汽车商品进口金额及同比增长变化情况

图表 2019年月度汽车进口量及同比增长变化情况

图表 2019年整车主要品种进口量构成

图表 2019年乘用车三大类品种分排量进口情况

图表 2015-2019年汽车整车进口量及同比增长变化情况

图表 2015-2019年汽车零部件进口金额及同比增长变化情况

图表 2019年前十名进口来源国进口金额所占比重

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qiche/Y16189MBPE.html>